

トップゼクロムPLUSプロセス

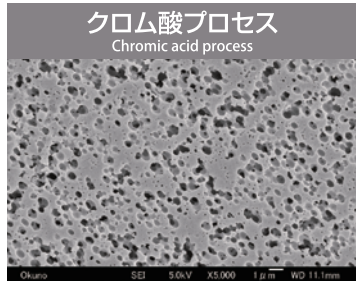
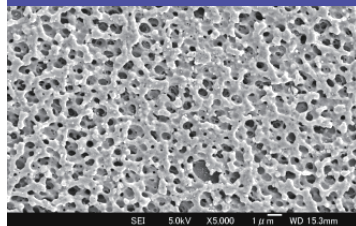
TOP ZECROM PLUS PROCESS

- クロム酸プロセスと同等以上の高いエッチング力と密着性
Ensure strong etching power and high adhesion compared with chromic acid process
- 大幅な工程短縮を実現
Greatly can shorten the number of steps
- 環境負荷物質であるクロム酸および高価なパラジウムを使用しない
Not use environmentally damaging chromic acid, not use expensive palladium

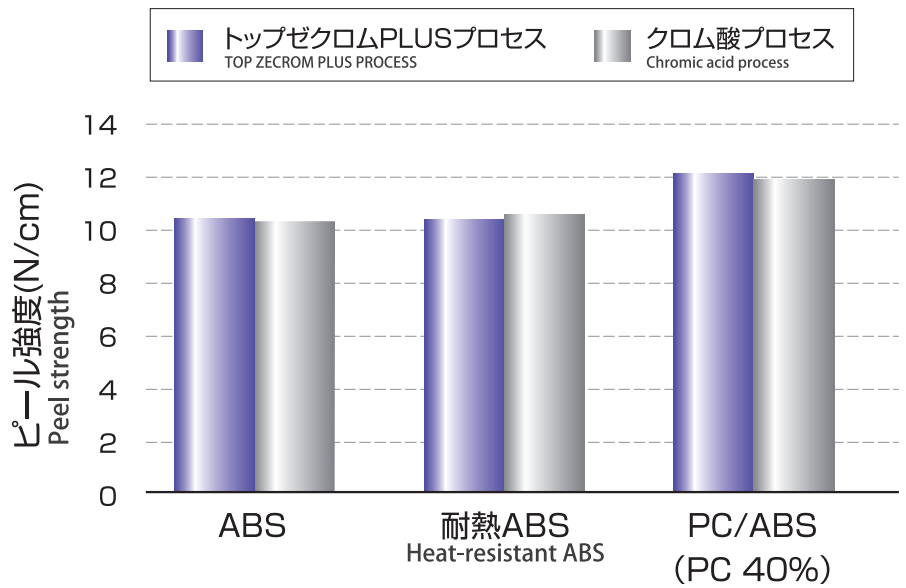
優れたエッチング力と密着性

Strong etching power and high adhesion performance

トップゼクロムPLUSプロセス
TOP ZECROM PLUS PROCESS

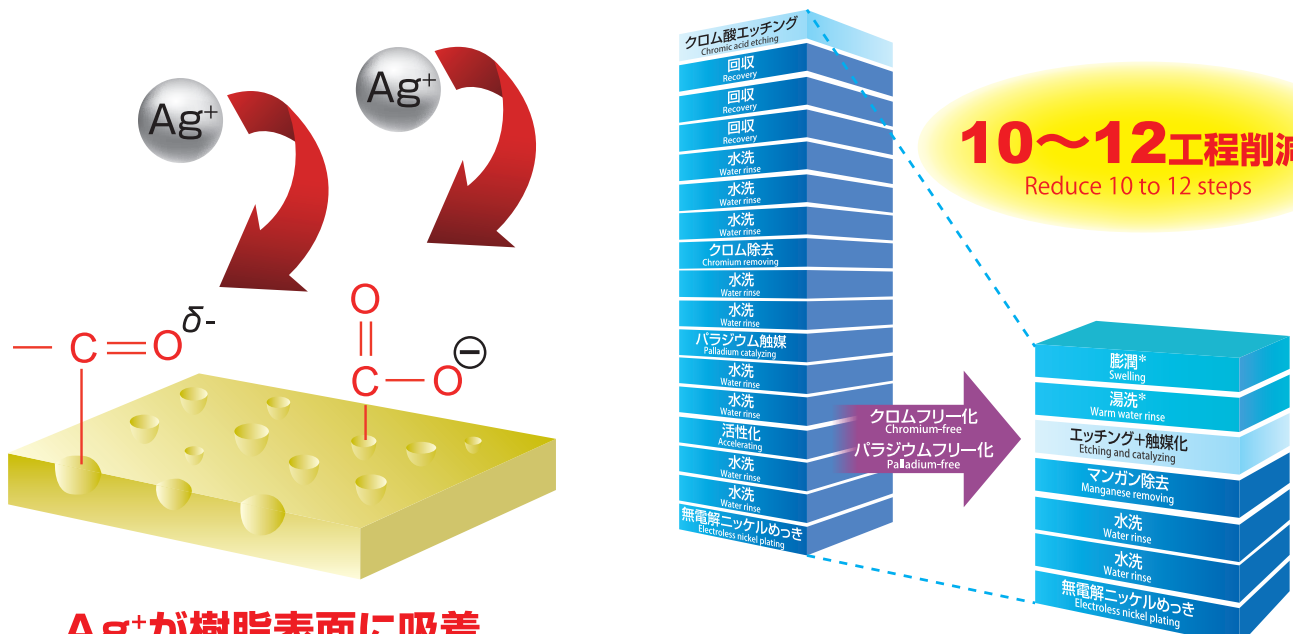


UMG ABS 3001M
5000倍SEM像 10分エッチング
SEM image(5000 magnification) After 10 min etching



微細孔形成と同時に触媒を付与し、大幅に工程を短縮

Etching and catalyzing can be conducted in 1 step and can reduce steps significantly



Ag⁺が樹脂表面に吸着
Ag⁺ adsorb on plastic

*PC/ABSの場合には必要
Necessary for PC/ABS